

//hyu.wiki/%EB%A7%88%EC%9D%B4%ED%81%AC%EB%A1%9C%ED%8C%A8%ED%82%A4%EC%A7%95_%EB%B0%8F_%EB%82%98%EB%85%B8%EC%86%8C%EC%9E%AC_%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%8B%A4

마이크로패키징 및 나노소재 연구실

본 연구실에서 진행하고 있는 연구는 크게 2가지로 나눌 수 있습니다, (1) 마이크로 시스템의 패키징 기술 (2) 나노 입자가 분산된 유무기 복합 박막의 제조와 그 응용 휴대폰 등의 휴대용 전자 부품은 다기능화, 고속도화, 계량화, 박판화 되고 있습니다. 이런 기능을 만족시키기 위해서는 마이크로 시스템의 고성능 off-chip interconnection 기술이 필요합니다. 본 연구실에서는 이런 마이크로 시스템의 off-chip interconnection 기술인 마이크로 시스템 패키징에 관한 연구를 하고 있습니다. 구체적으로 3차원 chip 적층을 위한 TSV 접합공정, 고성능 Flip chip bonding, 평판 디스플레이 구동회로 실장기술, 고 신뢰성 무연솔더 접합부 개발 등에 관한 연구를 진행하고 있습니다. 또한 폴리이미드 내에 고밀도의 나노입자를 형성하여 전자소자, 광소자에 응용시키기 위한 연구 등을 수행 중입니다.

- 소속: 서울 [공과대학 신소재공학부](#)
- 영문명: Microsystems Packaging & Nanomaterials Lab
- 실장: [김영호 신소재공학부](#) 교수
- 홈페이지: <http://packaging.hanyang.ac.kr>